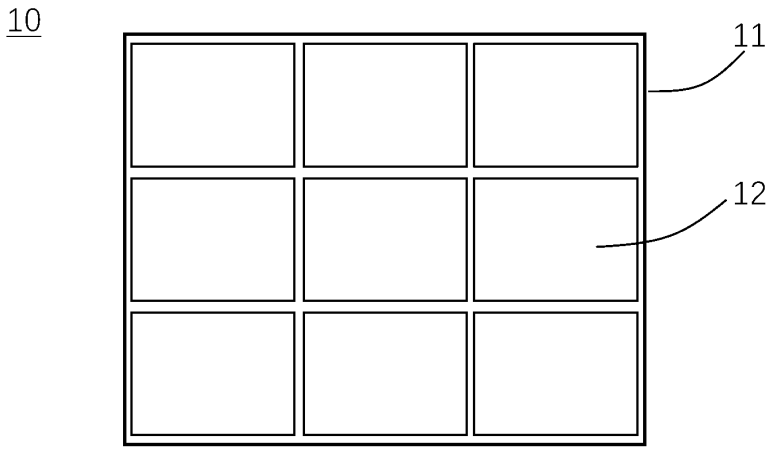


图 1A

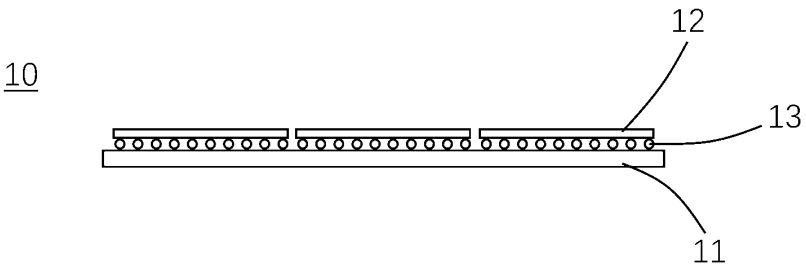


图 1B

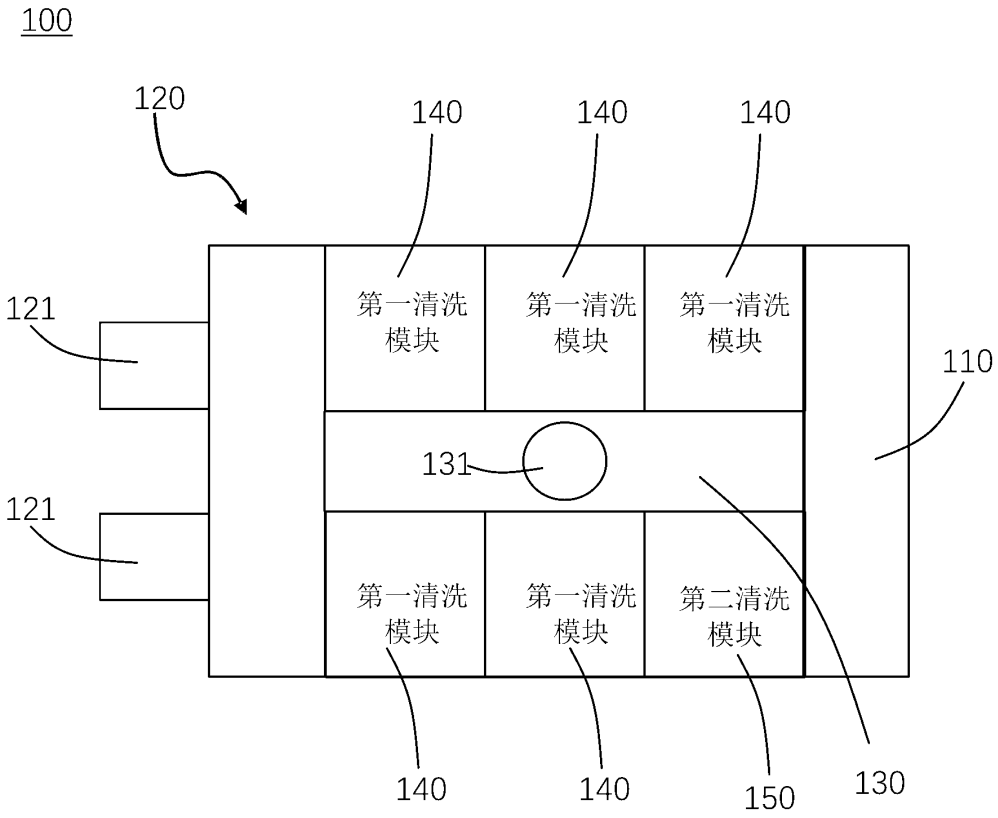

100
120
140
140
140
121
第一清洗模块
第一清洗模块
第一清洗模块
110
131
121
第一清洗模块
第一清洗模块
第二清洗模块
140
140
150
130

图 2

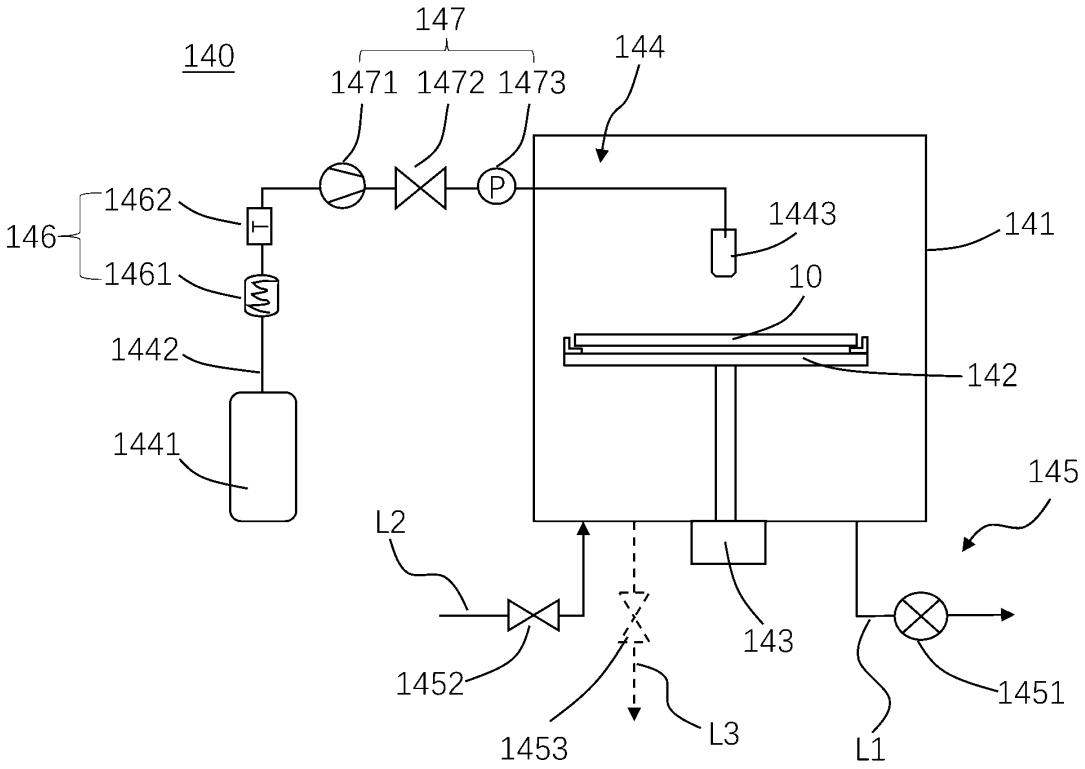

147
140
1471
1472
1473
144
1462
146
1461
1442
1441
1443
141
10
142
145
L2
1452
1453
L3
143
1451
L1

图 3

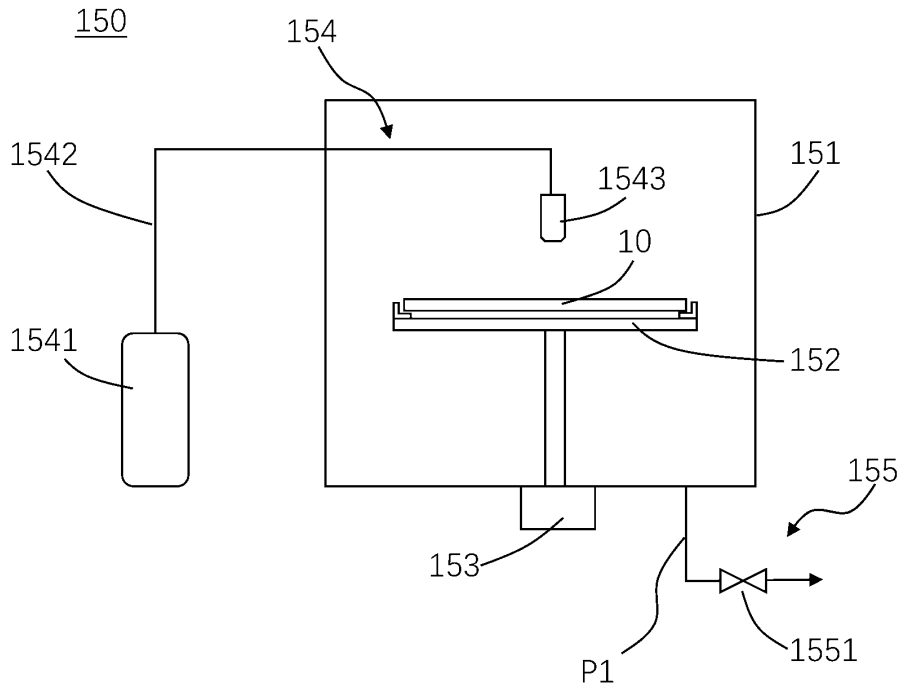


图 4

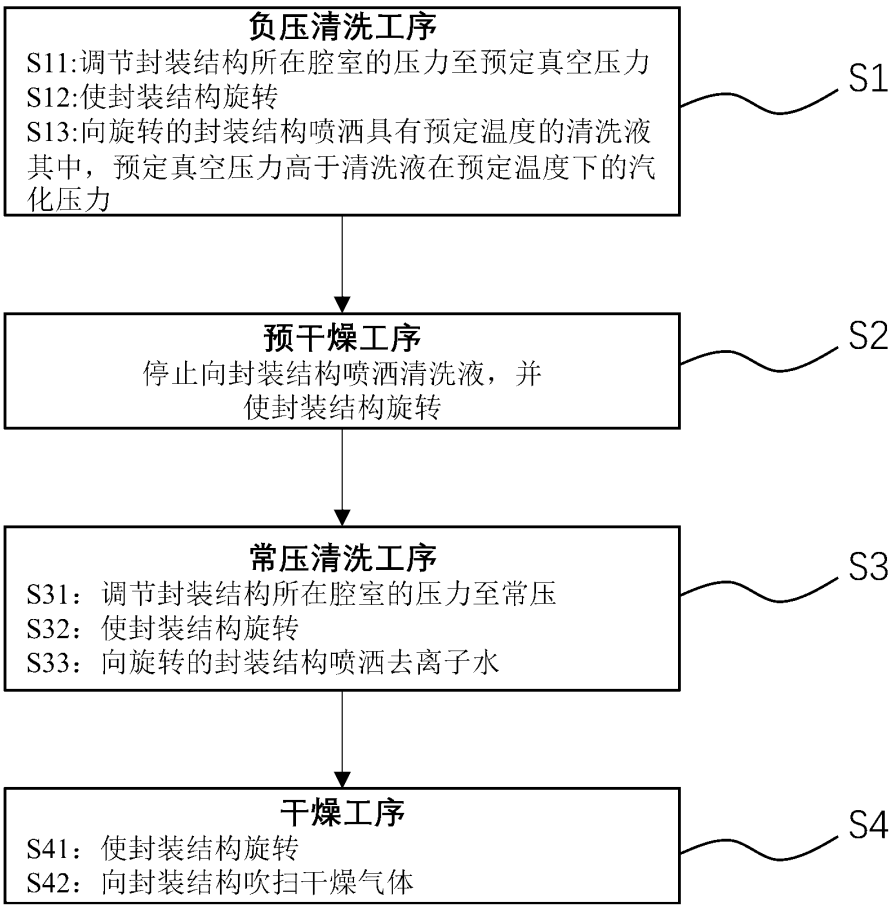

负压清洗工序
S11:调节封装结构所在腔室的压力至预定真空压力
S12:使封装结构旋转
S13:向旋转的封装结构喷洒具有预定温度的清洗液
其中，预定真空压力高于清洗液在预定温度下的汽化压力
S1
预干燥工序
停止向封装结构喷洒清洗液，并
使封装结构旋转
S2
常压清洗工序
S31：调节封装结构所在腔室的压力至常压
S32：使封装结构旋转
S33：向旋转的封装结构喷洒去离子水
S3
干燥工序
S41：使封装结构旋转
S42：向封装结构吹扫干燥气体
S4

图 5

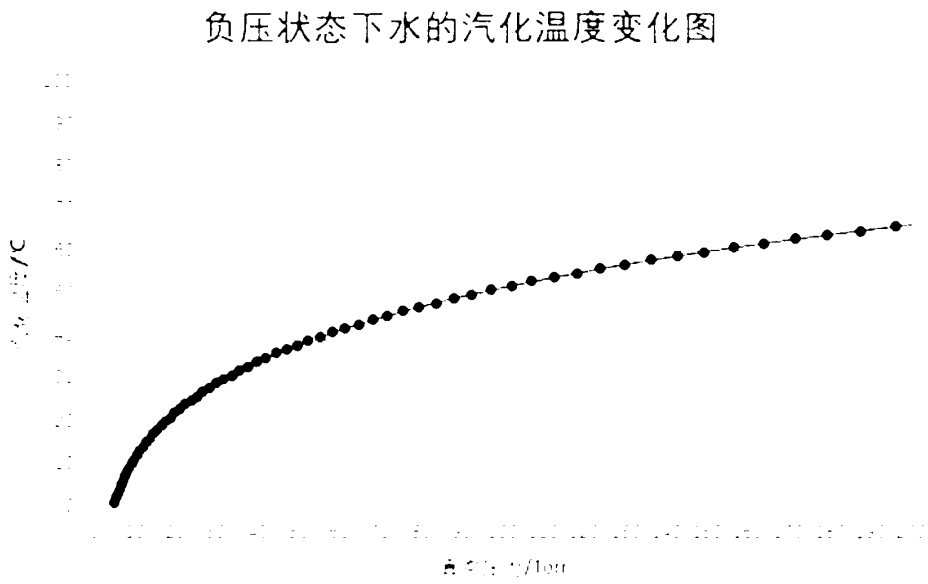


图 6

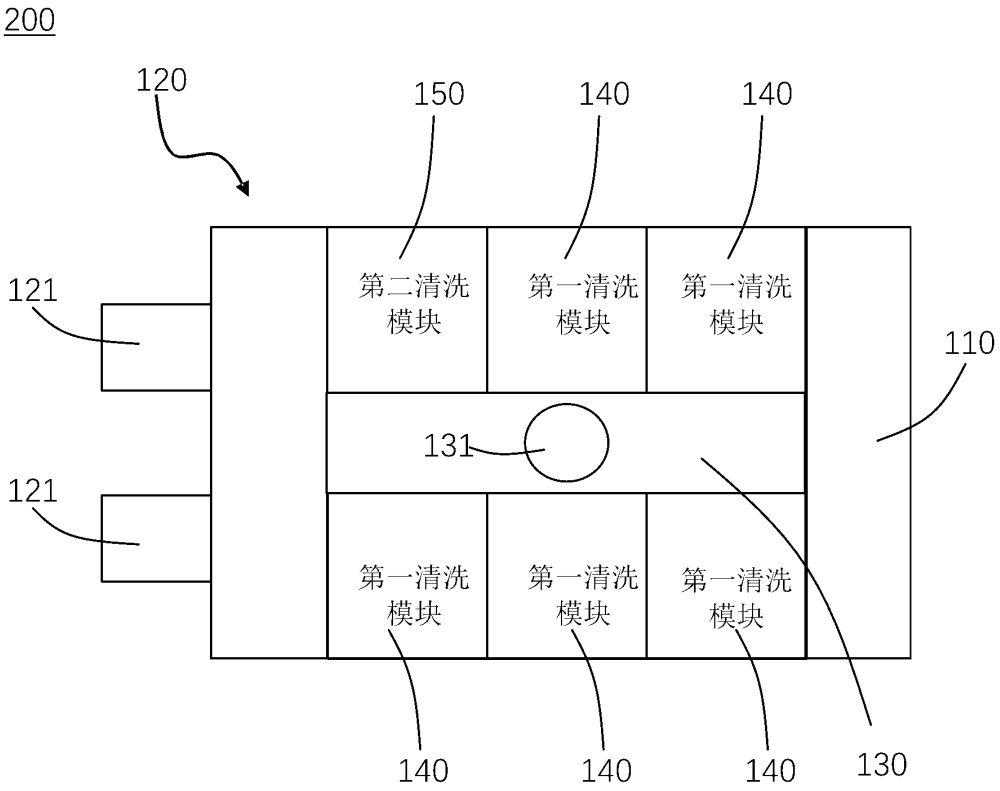

200
120
150
140
140
121
第二清洗模块
第一清洗模块
第一清洗模块
110
131
121
第一清洗模块
第一清洗模块
第一清洗模块
140
140
140
130

图 7

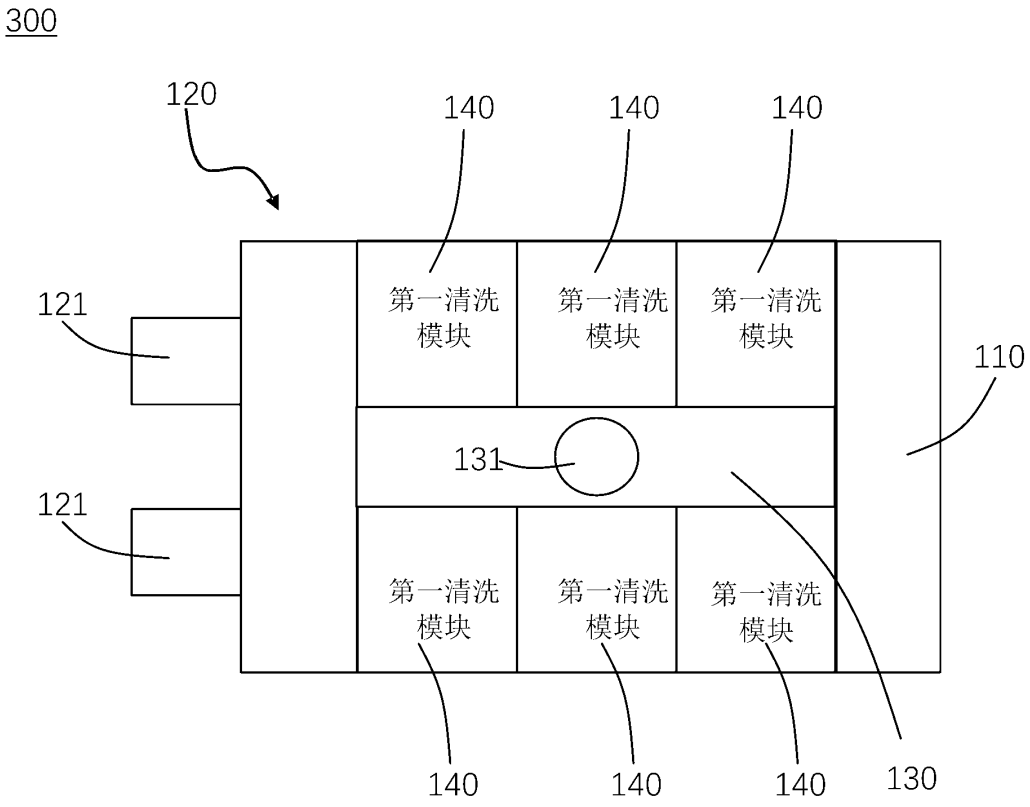

300
120
140
140
140
121
第一清洗模块
第一清洗模块
第一清洗模块
110
131
121
第一清洗模块
第一清洗模块
第一清洗模块
140
140
140
130

图 8

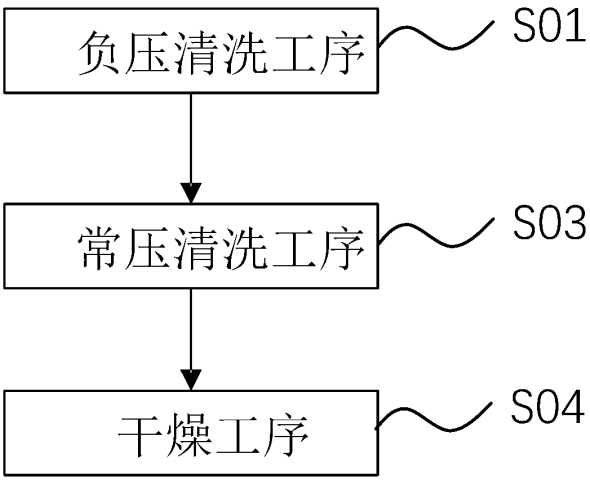


图 9